Pâte à braser NO-CLEAN TLF-204-171A, sans plomb, pour processus d'impression, 1 cartouche = 600 g

La pâte à braser sans plomb TLF-204-171AK a été développée pour répondre aux exigences des processus d'impression. La pâte offre d'excellentes propriétés d'impression, évitant aussi bien le cold slump que le hot slump et donc la formation de ponts indésirables. Grâce à l'activation améliorée du flux, la TLF-204-171AK permet de minimiser les défauts de type "head-in-pillow". En même temps, la bonne activation conduit à un bon mouillage sur les surfaces métalliques habituelles. Les tests de mouillage et de perles de soudure ainsi que la stabilité des contours répondent aux exigences les plus élevées. La TLF-204-171AK est une pâte NO-CLEAN - les résidus peuvent rester sur les points de soudure sans causer de problèmes de corrosion ou d'électromigration.

- Pâte à braser NO-CLEAN, sans plomb
- pour les processus d'impression
- Classification ROL0
- Teneur en métal 88,5
- Alliage Sn96,5Ag3Cu0,5
- Taille de grain 4 (20-38 µm)
- 1 cartouche = 600 g
- Réduction des défauts "head-in-pillow".
- Activité élevée sur tous les substrats
- Bon mouillage sur les surfaces métalliques habituelles
- excellentes propriétés d'impression
- Bonne adhésivité jusqu'à 24h
- Classification du flux J-STD-004 : ROL0

Numéro d'article	**WL45185**
Modèle	Pastentyp TLF-204-171AK
Fabricant	TAMURA ELSOLD
Numéro d'article du fabricant	LOTPAST8004
Données du fabricant du GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Unité de vente	1 cartouche
Unité de contenu	600 g
Classe de flux	ROL0
Sans plomb/contenant du plomb	sans plomb